



Advance Materials Corporation

聯致科技股份有限公司

軟性印刷電路板材料

純膠產品技術資料

地址：桃園縣楊梅縣中山北路二段256巷168號 電話：+886-3-4315168 傳真：+886-3-4813206

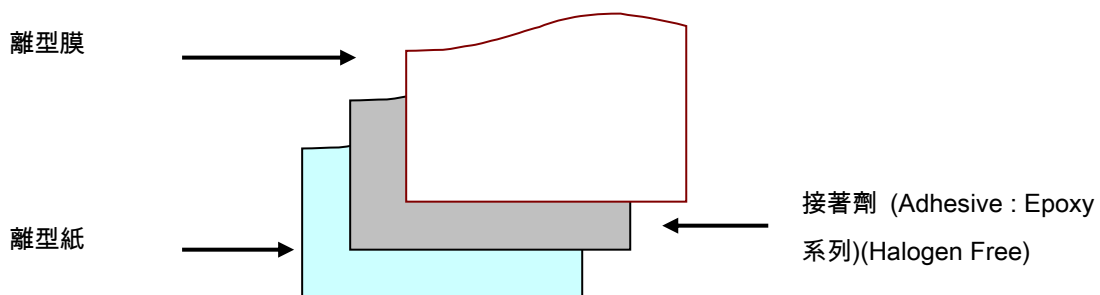
Address : No. 168, Lane 256, Sec.2, Chungshan North Rd., Yangmei, Taoyuan, Taiwan Tel : +886-3-4315168 Fax : +886-3-4813206



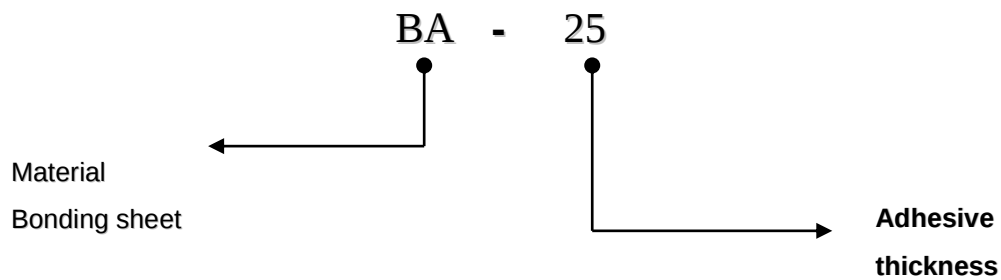
1、產品特性

1. 低鹵素含量。
2. 低吸濕性。
3. 耐熱性佳及附著力佳
4. 溢膠量小。

產品組成



編碼原則



產品規格

產品型號 (Name)	膠厚(μm) Thickness of Adhesive (μm)
BA-15	15
BA-25	25
BA-35	35
BA-50	50
BA-75	75
BA-100	100



Advance Materials Corporation

保存方式

純膠的黏膠為熱固性的產品，在壓合時會產生流動性進行填滿線路，達到驅趕氣泡與提高抗撕強度的功用。此流動性會隨保存環境與保存時間而異，為了在壓合時達到可靠的流動性與抗撕強度，建議保存在1~10°C 濕度 60%RH 以下的環境中。

產品認證

1. UL : E201676
2. SGS

FPC 假貼建議操作條件

溫度：80~120°C

壓力：1~5kgf/cm²

速度：1~4m/min

FPC 快速壓合建議操作條件

1. 壓合溫度：180°C(一段溫)
2. 壓合壓力：
 - a. 預壓段 ==> 0 kg/cm²
 - b. 成型段 ==> 80~100kgf/cm²
3. 壓合時間：
 - a. 預壓段 ==> 5~10 sec
 - b. 成型段 ==> 120 sec
4. 烘烤時間：
 - a. 烘烤溫度：160°C
 - b. 烘烤時間：60~90min

FPC 傳統平板壓合建議操作條件

壓合溫度：160°C(料溫)

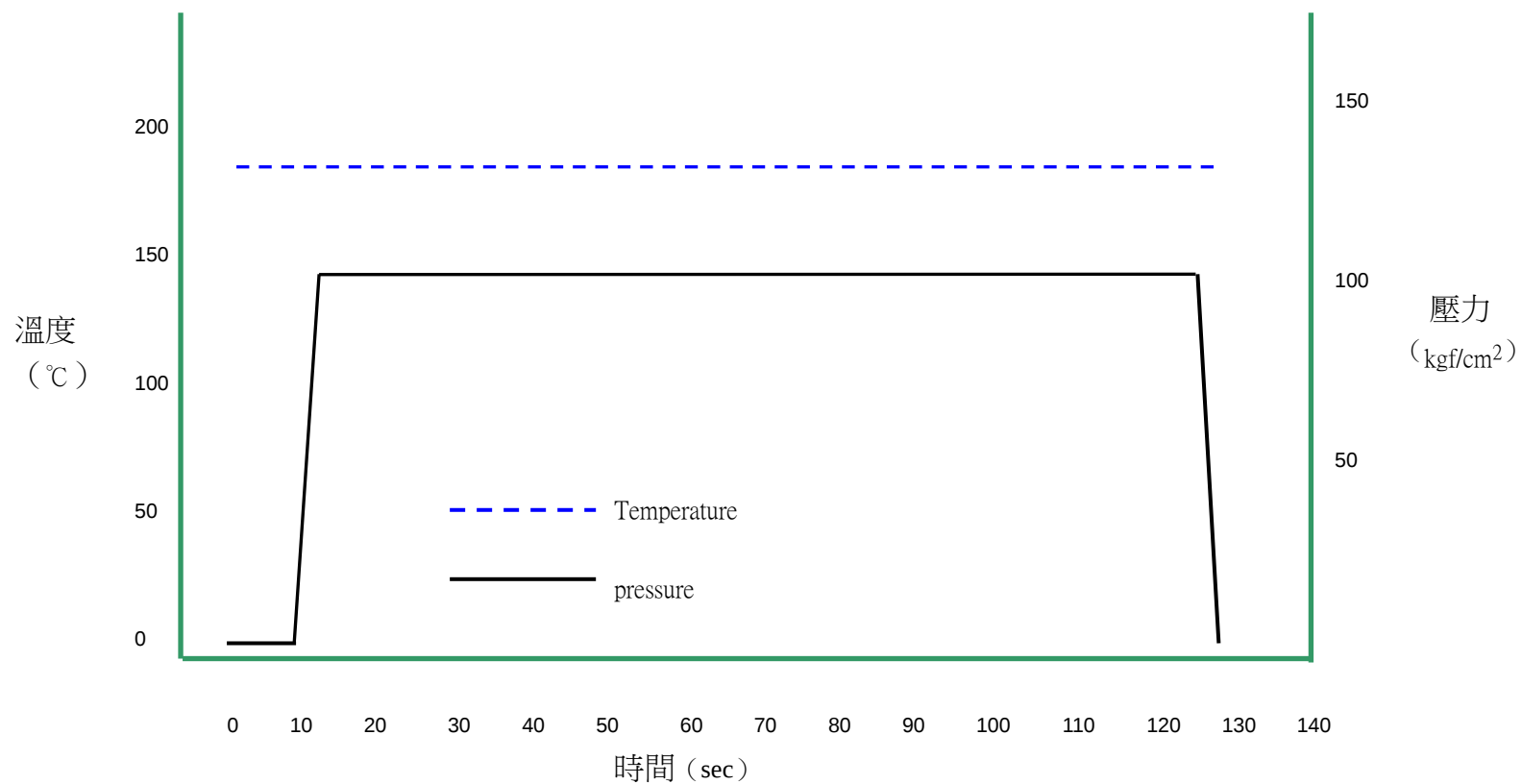
2. 壓合壓力：
 - a. 初段壓 ==> 35~40kgf/cm²
 - b. 高段壓 ==> 35~40kgf/cm²
3. 壓合時間：
 - a. 初段壓 ==> 每分鐘2~3°C進行升溫
 - b. 高段壓 ==> 160°C/60~ 90min



Advance Materials Corporation

FPC快速壓合曲線圖

(壓合建議曲線圖)



說明：

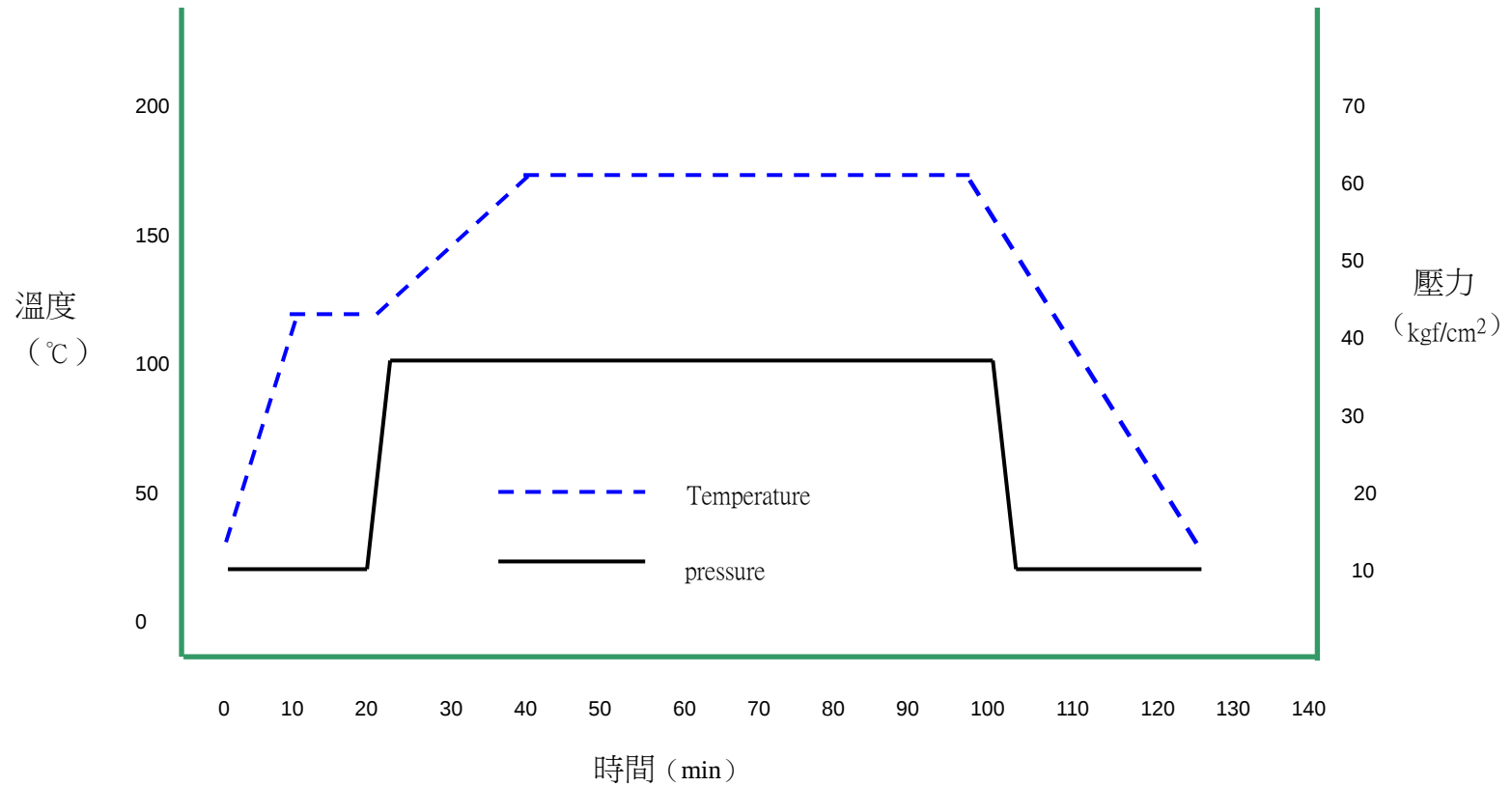
1. 於180°C下將待壓合成品置入，壓力為0 kgf/cm²。
2. 進行預壓段，時間約為5~10 秒。
3. 壓力升到80~100 kgf/cm²，壓合約80~120 秒。
4. 壓合後以160°C烘約60~90 分鐘。

備註：因各司機台設備及材料皆有差異，本司所提供之壓合條件僅供貴司參考，謝謝



FPC傳統平板壓合曲線圖

(壓合建議曲線圖)



說明：

1. 於溫度設定為25~40°C時將待壓品置入，壓力設定為35~40 kgf/cm²。
2. 以每分鐘2~3°C的溫度升溫，持續升溫至160°C。
3. 當溫度升溫至160°C(料溫)後，維持60~90 分鐘壓合時間。
4. 產品壓合完畢後，將產品進行冷壓，持續降溫。

備註：因各司機台設備及材料皆有差異，本司所提供之壓合條件僅供貴司參考，謝謝



Advance Materials Corporation

材料基本特性標準

ding sheet BA-15

Test Item		specification	Test Method
Adhesive thickness		15 um	
Peel Strength	As received	0.8 kgf/cm, above	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.7 kgf/cm, above	
	85°C/85%RH/96H	0.6 kgf/cm, above	----
Solder float		288°C × 10 sec × 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Resin Flow		≤0.20mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Aceton MEK	ALL PASS	



Bonding Sheet BA-25

Test Item		specification	Test Method
Adhesive thickness		25 um	
Peel Strength	As received	0.9 kgf/cm, above	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm, above	
	85°C/85%RH/96H	0.7 kgf/cm, above	----
Solder float		288°C × 10 sec × 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Resin Flow		≤0.25mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Aceton MEK	ALL PASS	



Bonding Sheet BA-35

Test Item		specification	Test Method
Adhesive thickness		35 um	----
Peel Strength	As received	0.9 kgf/cm, above	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm, above	
	85°C/85%RH/96H	0.7 kgf/cm, above	----
Solder float		288°C × 10 sec × 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Resin Flow		≤0.30mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Aceton MEK	ALL PASS	



Bonding Sheet BA-50

Test Item		specification	Test Method
Adhesive thickness		50 um	----
Peel Strength	As received	0.9 kgf/cm, above	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm, above	
	85°C/85%RH/96H	0.7 kgf/cm, above	----
Solder float		288°C × 10 sec × 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω), above	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Resin Flow		≤0.30mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Aceton MEK	ALL PASS	



Bonding Sheet BA-75

Test Item		specification	Test Method
Adhesive thickness		50 um	----
Peel Strength	As received	0.9 kgf/cm, above	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm, above	
	85°C/85%RH/96H	0.7 kgf/cm, above	----
Solder float		288°C × 10 sec × 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω), above	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Resin Flow		≤0.35mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Aceton MEK	ALL PASS	



Bonding Sheet BA-100

Test Item		specification	Test Method
Adhesive thickness		50 um	----
Peel Strength	As received	0.9 kgf/cm, above	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm, above	
	85°C/85%RH/96H	0.7 kgf/cm, above	----
Solder float		288°C × 10 sec × 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω), above	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω) , above	IPC-TM-650 2.5.17
Resin Flow		≤0.40mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Aceton MEK	ALL PASS	



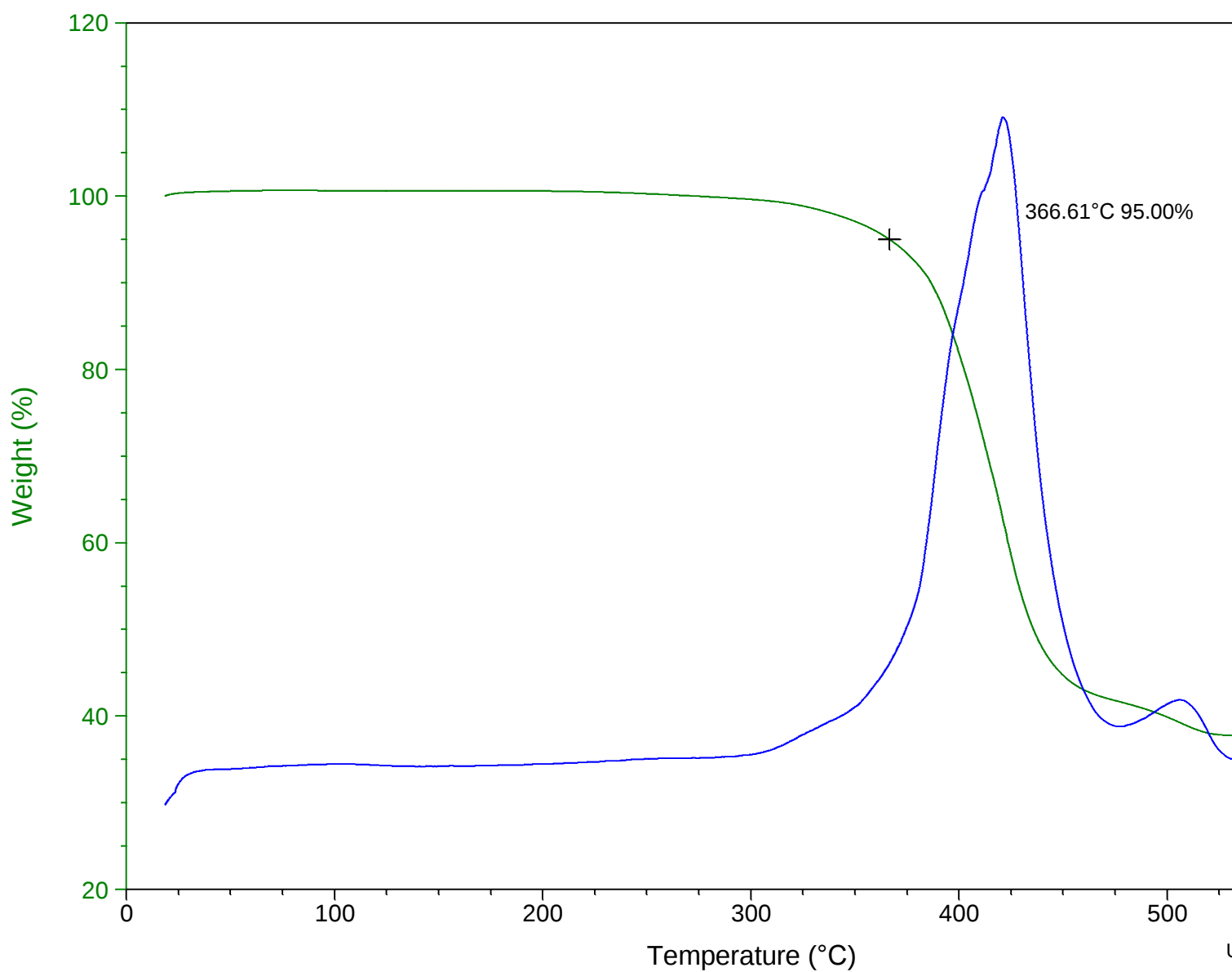
Advance Materials Corporation

The Decomposition Temperature for Bonding Sheet

Sample: AMC
Size: 5.1070 mg
Method: ramp10 600C

TGA

File: C:\...\todd\桌面\AMC
Operator: Faith
Run Date: 16-Feb-2009 0
Instrument: TGA Q500 V2



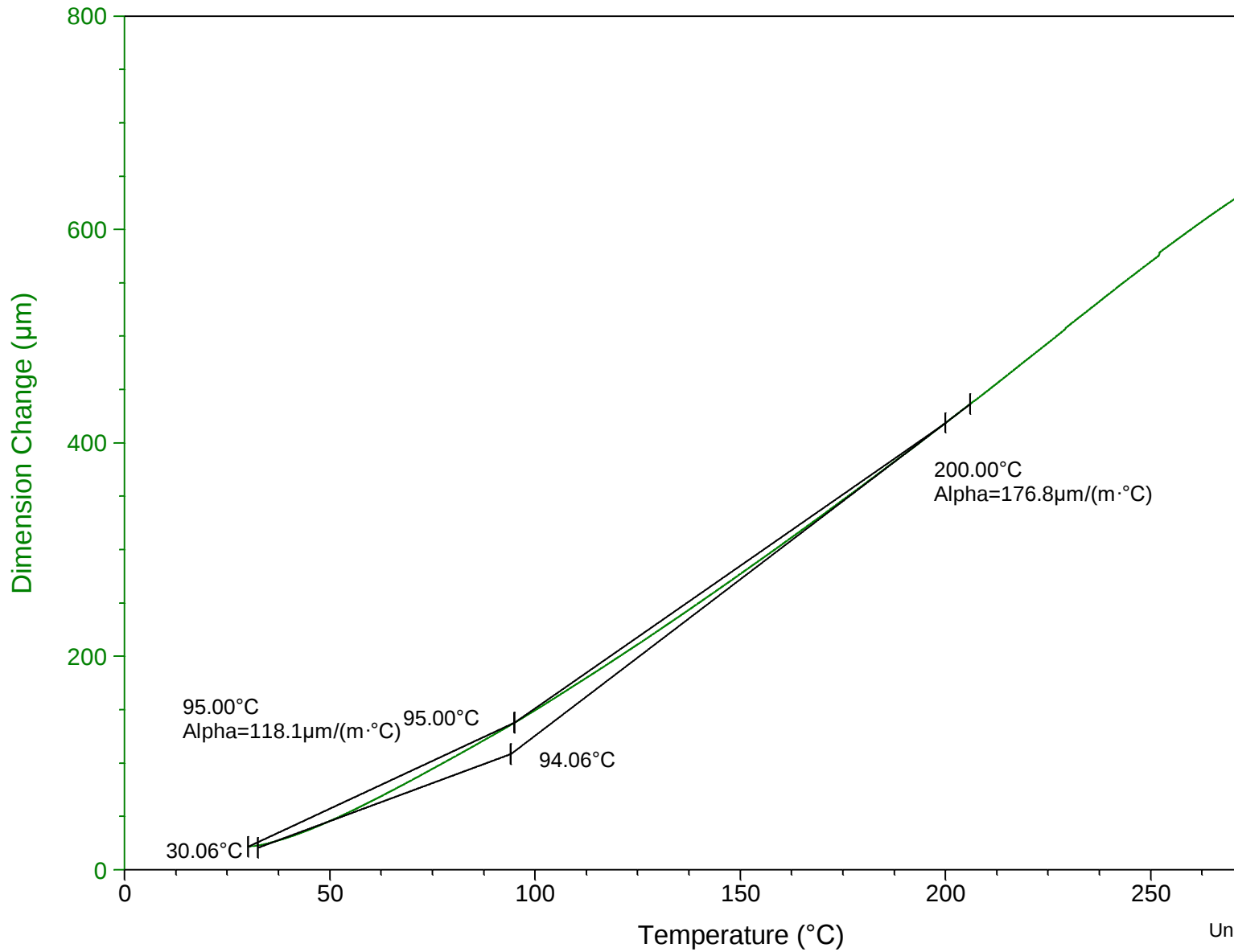


The Glass Transition Temperature for Bonding Sheet

Sample: AMC
Size: 15.1376 mm
Method: DC-CTE

TMA

File: E:\AMC.002
Operator: faith
Run Date: 13-Feb-2009 08:
Instrument: TMA Q400 V7.4





純膠撕膠注意事項

- 1：純膠裁張時，需做裁張記號，讓後製程撕膠時，判定撕膠方向。
- 2：純膠撕膠方向判定，裁張後以金像顯微鏡，確認斷面狀況，選擇未受到破壞的斷面進行撕膠。
- 3：當裁張斷面，A 斷面及 B 斷面，都被破壞時，需更換裁張刀具。
- 4：裁張時，紙張面朝上，裁張斷面會較佳(裁張設備不同，會有所差異)。
- 5：裁張及撕膠環境，最好是在有靜電消除裝置的環境中作業，可避免撕膠起泡異常。
- 6：作業環境溼度偏低時，容易造成靜電累積，造成撕膠異常，最好是在有環境溫溼度管控環境中，進行撕膠作業。